

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-07-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	长城证券 邹兰兰、苏雅萍、徐如钦 摩根士丹利基金 李子扬
时间	2024年7月24日（星期三）
地点	公司会议室（线上会议）
上市公司接待人姓名	副总经理/董事会秘书 李志萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书介绍公司基本情况</p> <p>二、互动交流</p> <p>1、公司目前的业务结构情况是什么？</p> <p>公司主营业务为半导体硅材料及其制品的研发、生产和销售。公司当前主营业务的经营布局如下：半导体硅单晶生长及晶棒加工以宁夏中晶为主要生产基地；半导体单晶硅片加工以浙江中晶与西安中晶为核心，该业务在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位；募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》以中晶新材料为实施主体，抛光硅片产品将会成为公司未来重要主营产品之一，当前处于增产上量和新客户认证过程中；江苏皋鑫在现有高频高压半导体芯片及器件产品基础上，《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》目前处于项目建设阶段，未来将进一步扩大产能、研发新品、丰富产品类型。</p>

2、公司有哪些业务板块，各自占比有多少？

公司作为国家高新技术企业,始终致力于高品质半导体单晶硅材料及其制品的研发、生产和销售。目前,公司研磨硅片业务板块占比较多,随着募投项目的投产上量及江苏皋鑫项目的建设实施,公司新产品、新业务未来将呈现增长态势。2023年,半导体单晶硅片占营业收入46.32%;半导体单晶硅棒占营业收入21%;半导体功率芯片及器件占营业收入31.92%。

3、公司一季度计提减值准备 1,258.07 万元，二季度计提减值准备 949.57 万元，公司计提减值出于什么考虑？

公司计提资产减值准备主要是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。未来在企业经营过程中,公司将根据实际情况判断计提与否,公司会按照信息披露相关规定履行信息披露义务,请您持续关注公司公告内容。

4、公司产品生产技术优势主要是哪些方面？

公司经过多年的自主研发和技术积累,掌握了多项半导体硅材料制造核心技术,涵盖了产品生产的整个工艺流程,包括晶体生长、硅片加工、质量检测等各个环节,所应用的核心技术均处于大批量的生产阶段。公司自主掌握了磁控直拉法(MCZ)拉晶技术、再投料直拉技术、金刚线多线切割技术、高精度重掺杂技术、高效率重掺砷单晶硅生长技术、高精度抛光硅片加工技术等多项半导体硅材料制造与加工技术的核心技术,同时拥有高频高压二极管研发和制造等多项功率器件用芯片制造核心技术。公司通过自主研发与核心技术,在提高生产效率、降低人工成本的同时,大

大提高了产品的竞争力、夯实了公司的行业领先地位，也提升了公司面对复杂多变外部环境的应对能力。

5、公司在半年报预告中显示扭亏为盈，请预计一下下半年的经营情况？

公司上半年生产经营积极向好，下半年将持续培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户，加大市场开拓力度，提高公司市场规模。

6、公司募投项目固定资产折旧年限多少？

公司根据相关法律要求及会计政策规定，按照固定资产具体折旧方法进行计提折旧，房屋及建筑物 20 年，机器设备 5-15 年，运输设备 5 年，办公及其他设备 3-5 年，光电设备 10 年。具体内容已在年报中相应章节披露，敬请查阅。

7、公司目前股票回购进展如何？

目前公司已完成部分股份的回购，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计回购 230,000 股，成交总金额为 4,989,205.00 元(不含交易费用)，后续将继续按计划推进回购工作，详细信息可以关注公司发布的回购进展公告。

8、请介绍江苏皋鑫芯片业务产品下游应用分布情况。

江苏皋鑫拥有国际先进水平的塑封高压二极管制造技术，具有行业领先的产品设计和产品应用技术的研发能力，主营产品为半导体功率芯片及器件，广泛应用于微波炉、激光打印机、复印机、CRT/TV 显示器、X 光机及大型医疗设备、负离子发生器、空气净化、激光切割、高压静电喷涂、工业静电设备、油田设备、高压电源等领域。

	<p>9、请问公司目前产品市场覆盖面如何？</p> <p>公司自成立以来一直专注于半导体单晶硅材料及其制品的研发、生产和销售，凭借持续的自主创新，长期积累形成的技术优势、管理经验和产能规模优势，公司已在国内分立器件用单晶硅棒、研磨硅片以及半导体功率芯片及器件领域占据领先的市场地位。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年7月24日